

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯国际集成电路制造有限公司*

(于开曼群岛注册成立之有限公司)
(股份代号: 0981)

中芯截至二零零六年九月三十日止三个月业绩公布

- 国际主要半导体代工制造商中芯国际集成电路制造有限公司（纽约交易所SMI；香港联交所：981）【中芯】或【本公司】于今日公布截至二零零六年九月三十日止三个月的综合经营业绩。二零零六年第三季的销售额与二零零六年第二季相比上升 2.1%至 368,900,000 元，与二零零五年第三季度相比上升 19.0%。毛利率由二零零六年第二季的 13.6%降至二零零六年第三季的 8.9%。二零零六年第三季的经营亏损为 13,400,000 元。二零零六年第三季的净亏损为 5,100,000 元，二零零六年第二季为净收入 2,200,000 元以及二零零五年第三季度为净亏损 26,100,000 元。
- 以下为本公司于二零零六年十月三十一日就截至二零零六年九月三十日止三个月的未经审核业绩在报章所作的报章公布全文。
- 本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.09(1)条规定的披露责任于二零零六年十月三十一日作出本公布。

以下为本公司于二零零六年十月三十一日就截至二零零六年九月三十日止三个月的未经审核业绩在报章所作的报章公布全文。

所有货币数字主要以美元列账，除非特别指明。

报告内的财务报表数额按美国公认会计原则厘定。

概要

- 二零零六年第三季的销售额与二零零六年第二季相比上升 2.1%至 368,900,000 元，与二零零五年第三季度相比上升 19.0%。
- 毛利率由二零零六年第二季的 13.6%降至二零零六年第三季的 8.9%。
- 二零零六年第三季的经营亏损为 13,400,000 元。

- 二零零六年第三季的净亏损为 35,100,000 元，二零零六年第二季为净收入 2,200,000 元以及二零零五年第三季度为净亏损 26,100,000 元。

中国上海—二零零六年十月三十一日—国际主要半导体代工制造商中芯国际集成电路制造有限公司（纽约交易所：SMI；香港联交所：981）（「中芯」或「本公司」）于今日公布截至二零零六年九月三十日止三个月的综合经营业绩。二零零六年第三季销售额由上一季度的 361,400,000 元上升 2.1%至 368,900,000 元。本公司的月产能增至 76,625 片 8 吋等值晶圆，二零零六年第三季的使用率为 84.3%。与二零零六年第二季 13.6% 的毛利率相比，二零零六年第三季的毛利率为 8.9%。与二零零五年第三季的净亏损 26,100,000 元及二零零六年第二季的净收入 2,200,000 元相比，二零零六年第三季为净亏损 35,100,000 元。

公司目前与台积电间的诉讼涉及帐面价值为九千九百五十万美元的无形资产，公司列记该无形资产为台积电授权之专利及台积电承诺不对有关公司不当获取其商业秘密之指控提出诉讼。依 SFAS 144 之规定，公司应就本诉讼是否构成必须进一步分析该无形资产是否减损之特定事件作出决定。我们认为本诉讼现在处於最初阶段而我们仍将继续评估本诉讼是否构成前述事件，公司预期将获取更多有用之信息而有助於公司作出决定。依 SFAS 144 之规定所作减损分析之结果可能对公司之财务状况及营运结果产生重要影响。

“我们第一批 90 纳米逻辑产品已于第三季在北京 12 吋厂量产”中芯国际总裁张汝京博士说：“尔必达的 512M-bit DDR2 DRAM 产品的 90 纳米制程亦进入量产阶段。我们第二个 90 纳米产品，与奇梦达合作的 DRAM 项目，亦将于 2006 年第四季投产。在第三季，90 纳米产品收益占晶圆总营收的 4.9%。”

同时我们很高兴的宣布，中芯国际与高通订立了策略协议。我们将在天津厂房以特殊 BiCMOS 技术为高通提供集成电路制造服务。这一合作将综合中芯国际晶片制造能力以及转包能力和高通公司在 3G 无线产业的领导地位，重点将放在电源管理芯片方面。

我们持续关注客户的存货调整对第四季的影响。目前库存情形于改善中，并预期假期销售后库存情形将持续改善。

基于永续经营理念，我们将不断努力迈向领先科技。我们持续着重投入技术与开发，65 纳米技术方面，可望于 2007 年下半年获见成果。我们将以重归获利为明确目标 并以审慎的财务纪律拓展我们的业务。

电话会议 / 网上业绩公布详情

日期：二零零六年十月三十一日

时间：上海时间上午八时正

拨号及登入密码：美国1-617-597-5342（密码：SMIC）或香港852-3002-1672（密码：SMIC）。

二零零六年第三季业绩公布网上直播可于 www.smics.com 网站「投资者关系」一栏收听。中芯网站在网上广播后为十二个月提供网上广播录音版本连同本新闻发布的软拷贝。

关于中芯国际

中芯国际（纽约证券交易所：SMI，香港联合交易所：0981）总部位于中国上海，是世界领先的集成电路芯片代工公司之一，也是中国内地最大及最先进的芯片代工公司。向全世界客户提供0.35微米到90纳米及更先进工艺的芯片制造服务。公司在上海营运三座8英寸芯片厂，在天津营运一座8英寸芯片厂，并在北京营运一座12英寸芯片厂，此为内地第一座正式营运之12英寸芯片厂。此外，中芯国际还在美国、意大利、日本提供客户服务和设立销售办事处，同时在香港设立了代表处。敬请访问公司网站：<http://www.smics.com>

安全港声明

（根据1995私人有价证券诉讼改革法案）

本次新闻发布可能载有（除历史资料外）依据1995年美国私人有价证券诉讼改革法案的“安全港”条文所界定的「前瞻性陈述」。该等前瞻性陈述，包括在随后“资本开支概要”和“二零零六年第四季度指引”中的声明乃根据中芯对未来事件的现行假设、期望及预测而作出。中芯使用「相信」、「预期」、「计划」、「估计」、「预计」、「预测」及类似表述性陈述前瞻性之标识，尽管并非所有前瞻性陈述均包含上述字眼。该等前瞻性陈述乃反映中芯高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知风险、不确定性，以及其它可能导致中芯实际业绩、财政状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料存在重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场状况有关的风险、激烈竞争、中芯客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造生产量供给及最终市场的金融局势是否稳定。

投资者应考虑中芯呈交予美国证券交易委员会（「证交会」）的文件资料，包括其于二零零六年六月二十九日以20-F表格形式呈交予证交会的经修订的年度报告，特别是「风险因素」及「有关财政状况及经营业绩的管理层讨论及分析」两个部份，以及其于二零零四年三月八日以A-1表格形式呈交予香港联合交易所（「香港联交所」）的登记声明，以及中芯可能不时向证交会及香港联交所呈交的该等其它文件，包括6-K表格。其它未知或不可预知的因素亦可能会对中芯日后的业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于上述风险、不确定性、假设及因素，本新闻发布中提及的前瞻性事件可能不会发生。务请阁下注意，切勿过份依赖此等前瞻性陈述，此等陈述仅就本新闻发布中所载述日期（或如无有关日期，则为本新闻发布日期）的情况而表述。除法律有所规定以外，中芯概不就因新资料、未来事件或其它原因引起的任何情况承担任何责任，亦不拟更新任何前瞻性陈述。

投资者联络资料:

Peter Yu

电话: +86-21-5080-2000, 内线: 11319

peter_yu@smics.com

手机: +86-13918940553

Douglas Hsiung

电话: +86-21-5080-2000, 内线: 12804

Douglas_hsiung@smics.com

手机: +86-13795272240

二零零六年第三季经营业绩概要:

以千美元为单位 (每股盈利和百分比除外)

	<u>二零零六年</u> <u>第三季度</u>	<u>二零零六年</u> <u>第二季度</u>	<u>季度比较</u>	<u>二零零五年</u> <u>第三季度</u>	<u>年度比较</u>
销售收入	368,926	361,446	2.1%	309,959	19.0%
销售成本	336,160	312,229	7.7%	284,686	18.1%
毛利	32,766	49,217	-33.4%	25,273	29.6%
经营开支	46,190	56,141	-17.7%	46,219	-0.1%
经营亏损	(13,424)	(6,924)	93.9%	(20,946)	-35.9%
其它收入(支出)	(20,947)	(9,491)	120.7%	(4,742)	341.7%
所得税利益(支出)	3,048	18,892	-83.9%	(6)	-
税后净收入(亏损)	(31,323)	2,477	-	(25,694)	21.9%
少数股权	(2,674)	767	-	439	-
应占联营公司亏损	(1,097)	(1,002)	9.5%	(860)	27.6%
普通股持有人应占收入(亏损)	(35,094)	2,242	-	(26,115)	34.4%
毛利率	8.9%	13.6%		8.2%	
经营利润率	-3.6%	-1.9%		-6.8%	
每股普通股股份净收入(亏损) - 基本(1)	(\$0.0019)	\$0.0001		(\$0.0010)	
每股美国预托股份净收入(亏损) - 基本	(\$0.0956)	\$0.0061		(\$0.0718)	
每股普通股股份净收入(亏损) - 摊薄(1)	(\$0.0019)	\$0.0001		(\$0.0010)	
每股美国预托股份净收入(亏损) - 摊薄	(\$0.0956)	\$0.0060		(\$0.0718)	
付运晶圆(8吋等值)(2)	413,985	388,498	6.6%	355,664	16.4%
逻辑平均售价(3)	\$949	\$979	-3.1%	\$989	-4.0%
综合平均售价	\$851	\$888	-4.2%	\$841	1.2%
简化平均售价(4)	\$891	\$930	-4.2%	\$871	2.3%
产能使用率	84.3%	93.5%		92.1%	

附注:

(1) 基于二零零六年第三季加权平均普通股 18,356,000,000 股, 二零零六年第二季 18,303,000,000 股 (基本) 及 18,729,000,000 股 (摊薄), 二零零五年第三季度 8,180,000,000 股。

(2) 包括铜接连件

(3) 不包括铜接连件

(4)销售总额/晶圆付运总数

- 二零零六年第三季销售额升至 368,900,000 元,较二零零六年第二季的 361,400,000 元录得季度升幅 2.1%,并较二零零五年第三季度的310,000,000 元录得年度升幅 19.0% 主要由于 8 吋等值晶圆付运数量增至 413,985 片,与二零零六年第二季的 388,498 片相比录得季度升幅 6.6%
- 销售成本从二零零六年第二季的 312,200,000 元上升 7.7%至二零零六年第三季的 336,200,000 元,主要由于晶圆付运数量增加及折旧费用上升所致。
- 二零零六年第三季毛利下降至 32,800,000 元,较二零零六年第二季的 49,200,000 元录得季度降幅 33.4%;较二零零五年第三季度的 25,300,000 元录得年度升幅 29.6%。季度下降主要是由于总体价格疲软,产能使用率下降及折旧费用上升所致。
- 毛利率从二零零六年第二季的 13.6%下降至二零零六年第三季 8.9%,主要是由于总体价格疲软、使用率下降及折旧费用上升所致。
- 二零零六年第三季的研发费用增加至 27,300,000 元,较二零零六年第二季的24,300,000 元录得季度升幅 12.2%主要由于 65 纳米技术的研究开发活动及研发补助减少所致。
- 一般行政费用(包括汇兑损益)由二零零六年第二季的16,800,000 元下降至二零零六年第三季的 4,200,000 元,主要是由于二零零六年第三季与经营活动相关的汇兑收益为 2,300,000 元,坏帐准备下降,税费冲销及律师费用冲销所致。
- 二零零六年第三季的销售及市场推广相关费用下降至 3,600,000 元,较二零零六年第二季 3,900,000 元录得季度降幅 7.8%,主要由于与销售行为相关的工程材料耗用下降所致。
- 取得无形资产摊销指与所获无形资产相关的摊销费用于二零零六年第三季为 11,000,000 元。
- 二零零六年第三季的经营亏损增加至 13,400,000 元,较二零零六年第二季的经营亏损,900,000 元录得季度升幅 93.9%,较二零零五年第三季度的经营亏损 20,900,000 元有所下降。
- 其它非经营性亏损由二零零六年第二季的 9,500,000 元上升 120.7%至二零零六年第三季的 20,900,000 元,主要是由于 12,300,000 元的汇兑损失所致。
- 二零零六年第三季的利息开支为 12,200,000 元,与二零零六年第二季的 12,200,000 元相比录得季度增幅 0.3%。
- 汇兑净亏损为 10,100,000 元,其中一般行政费用中包括了汇兑收益2,300,000 元,与融资或投资活动相关的非经营性活动产生的汇兑亏损 12,300,000 元归类为其它收入(支出)
- 二零零六年第三季的净亏损增加为 35,100,000 元,二零零六年第二季为净收入 2,200,000 元及二零零五年第三季度为净亏损 26,100,000 元。

1. 收入分析

销售分析					
以应用分类	二零零六年 第三季	二零零六年 第二季	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季
计算机	33.0%	30.6%	36.0%	34.8%	33.7%
通讯	37.1%	46.2%	45.8%	43.8%	39.8%
消费	25.2%	18.6%	13.3%	16.6%	22.8%
其它	4.7%	4.6%	4.9%	4.8%	3.7%
以装置分类	二零零六年 第三季	二零零六年 第二季	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季
逻辑（包括铜接连件）	65.4%	66.6%	62.8%	65.3%	65.5%
记忆 (1)	30.1%	28.8%	32.4%	31.3%	31.0%
其它（光罩制造及探测等）	4.5%	4.6%	4.8%	3.4%	3.5%
以客户类别分类	二零零六年 第三季	二零零六年 第二季	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季
非厂房半导体公司	36.9%	49.8%	41.8%	43.2%	43.2%
集成装置制造商	50.4%	41.9%	52.8%	51.7%	52.8%
系统公司及其它	12.7%	8.3%	5.4%	5.1%	4.0%
以地区分类	二零零六年 第三季	二零零六年 第二季	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季
北美洲	38.6%	46.7%	43.5%	39.2%	42.9%
亚太区（不包括日本）	25.4%	20.9%	21.3%	28.2%	25.7%
日本	7.5%	4.9%	3.3%	3.6%	4.5%
欧洲	28.5%	27.5%	31.9%	29.0%	26.9%
晶圆收入分析					
各技术占晶圆销售额的百分比 （仅包括逻辑、记忆及铜接连件）	二零零六年 第三季	二零零六年 第二季	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季
0.09 微米	4.9%	0.9%	-	-	-
0.13 微米	41.2%	46.6%	46.6%	42.9%	43.8%
0.15 微米	7.2%	4.7%	8.7%	5.2%	2.7%
0.18 微米	36.1%	38.0%	35.7%	42.3%	45.3%
0.25 微米	2.6%	2.0%	1.6%	3.3%	3.1%
0.35 微米	8.0%	7.8%	7.4%	6.3%	5.1%
各逻辑技术占逻辑晶圆销售额百分比 (1)	二零零六年 第三季	二零零六年 第二季	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季
0.09 微米	4.6%	0.2%	-	-	-
0.13 微米 (2)	11.1%	22.3%	13.3%	10.9%	14.7%
0.15 微米	11.8%	7.2%	14.5%	8.6%	5.3%
0.18 微米	55.3%	55.8%	57.7%	65.3%	67.4%
0.25 微米	4.1%	2.5%	2.3%	4.8%	4.0%
0.35 微米	13.1%	12.0%	12.2%	10.4%	8.6%

附注:

- (1) 不包括 0.13 微米铜接连件
- (2) 代表来自于全流程制造晶圆的销售收入

- 二零零六年第三季 90 纳米技术的晶圆销售额占总晶圆销售额的百分比成长至 4.9%。
- 二零零六年第三季源自亚太区（不包括日本）及日本客户的销售额占总销售额的百分比与二零零六年第二季度的 20.9%及 4.9% 相比，分别上升至 25.4%及 7.5%。

• **产能:**

厂 / (晶圆尺寸)	二零零六年第三季 ⁽¹⁾	二零零六年第二季 ⁽¹⁾
一厂 (8 吋)	43,109	43,000
二厂 (8 吋)	49,000	49,034
四厂 (12 吋)	41,850	35,438
七厂 (8 吋)	20,000	17,216
每月晶圆装配总产能	153,959	144,688
铜接连件:		
三厂 (8 吋)	22,666	22,563
每月铜接连件总产能	22,666	22,563

附注:

- (1) 期终每月晶圆计 8 吋等值

- 截至二零零六年第三季度末，每月产能增加至 176,625 片 8 吋等值晶圆主要由于北京晶圆四厂和天津晶圆七厂产能扩张。

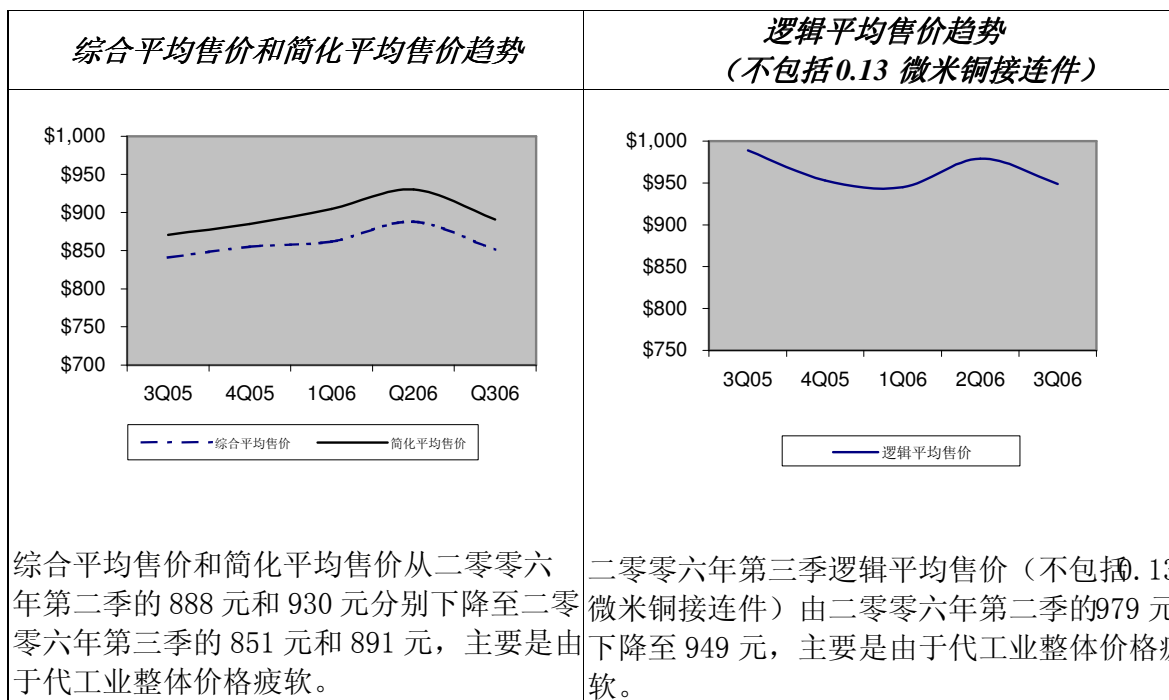
付运及使用率:

8 吋等值晶圆	二零零六年 第三季	二零零六年 第二季	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季
付运晶圆 (包括铜接连件)	413,985	388,498	388,010	376,227	355,664
使用率 ⁽¹⁾	84.3%	93.5%	94.9%	93.0%	92.1%

附注:

- (1) 产能使用率按输出晶圆总额除以估计产能计算

- 二零零六年第三季晶圆付运增加至 413,985 片 8 吋等值晶圆，较二零零六年第二季的 388,498 片 8 吋等值晶圆及二零零五年第三季度的 355,664 片 8 吋等值晶圆分别录得季度升幅 6.6%及年度升幅 16.4%。
- 使用率下降至 84.3%。



2. 详细财务分析

毛利分析

以千美元计	二零零六年 第三季	二零零六年 第二季	季度比较	二零零五年 第三季	年度比较
销售成本	336,160	312,229	7.7%	284,686	18.1%
折旧	196,993	188,663	4.4%	167,919	17.3%
其它制造成本	139,167	123,566	12.6%	116,767	19.2%
毛利	32,766	49,217	-33.4%	25,273	29.6%
毛利率	8.9%	13.6%		8.2%	

- 销售成本从二零零六年第二季 312,200,000 元增加 7.7% 至二零零六年第三季的 336,200,000 元, 主要由于晶圆付运数量增加及折旧费用上升所致。
- 二零零六年第三季毛利下降至 32,800,000 元, 与二零零六年第二季的 49,200,000 元相比录得季度降幅 33.4%, 与二零零五年第三季度的 25,300,000 元相比录得年度升幅 29.6%。季度下降主要是由于总体价格疲软, 产能使用率下降及折旧费用上升所致。
- 毛利率从二零零六年第二季的 13.6% 下降至二零零六年第三季的 8.9%, 主要是由于总体价格疲软, 产能使用率下降及折旧费用上升所致。

经营开支分析

以千美元计	二零零六年 第三季	二零零六年 第二季	季度比较	二零零五年 第三季	年度比较
总经营开支	46,190	56,141	-17.7%	46,219	-0.1%
研究及开发	27,319	24,345	12.2%	20,355	34.2%
一般及行政	4,216	16,837	-75.0%	10,526	-59.9%
销售及市场推广	3,614	3,918	-7.8%	4,677	-22.8%
无形资产摊销	11,041	11,041	-	10,661	3.6%

- 总经营开支从二零零六年第二季的 56,100,000 元下降至 46,200,000 元，录得季度降幅 17.7%。
- 二零零六年第三季的研发费用增加至 27,300,000 元，较二零零六年第二季的 24,300,000 元录得季度升幅 12.2% 主要由于 65 纳米技术的研究开发活动及研发补助的减少所致。
- 一般行政费用（包括汇兑损益）较二零零六年第二季的 16,800,000 元下降至二零零六年第三季的 4,200,000 元，主要是由于二零零六年第三季与经营活动相关的汇兑收益为 2,300,000 元，坏帐准备下降，税费冲销及律师费用冲销所致。
- 二零零六年第三季的销售及市场推广相关费用下降至 3,600,000 元，较二零零六年第二季 3,900,000 元录得季度降幅 7.8%，主要由于与销售行为相关的工程材料耗用下降所致。
- 取得无形资产摊销指与所获无形资产相关的摊销费用于二零零六年第三季为 11,000,000 元。

其它收入（支出）

以千美元计	二零零六年 第三季	二零零六年 第二季	季度比较	二零零五年 第三季	年度比较
其它收入(支出)	(20,947)	(9,491)	120.7%	(5,602)	273.9%
利息收入	2,970	4,039	-26.5%	3,278	-9.4%
利息支出	(12,247)	(12,214)	0.3%	(10,334)	18.5%
其它，净额	(11,670)	(1,316)	786.8%	1,454	-

- 二零零六年第三季其它非经营性亏损为 20,900,000 元，相较于二零零六年第二季度的亏损 9,500,000 元上升了 120.7%，主要是由于汇兑亏损 12,300,000 元所致。
- 二零零六年第三季的利息支出为 12,200,000 元，较二零零六年第二季度的 12,200,000 元录得季度升幅 0.3%

流动资金

以千美元计	二零零六年第三季	二零零六年第二季
现金及现金等价物	555,326	584,643
短期投资	52,442	3,487
应收账款	265,522	257,248
存货	243,957	217,592
其它	40,500	25,956
流动资产总计	1,157,747	1,088,926
应付账款	353,325	429,813
短期借款	45,000	118,284
长期借款的即期部份	47,160	47,160
其它	137,391	114,636
流动负债总计	582,876	709,893
现金比率	1.0x	0.8x
速动比率	1.5x	1.2x
流动比率	2.0x	1.5x

资本结构

以千美元计	二零零六年第三季	二零零六年第二季
现金及现金等价物	555,326	584,643
短期投资	52,442	3,487
长期票据即期部分	29,493	29,242
长期票据	91,314	90,537
短期借款	45,000	118,284
长期借款的即期部份	47,160	47,160
长期借款	963,139	830,743
总借款	1,055,299	996,187
现金净额	(568,338)	(527,836)
股东权益	2,999,854	3,028,259
总借款对权益比率	35.2%	32.9%

现金流量概要

以千美元计	二零零六年第三季	二零零六年第二季
净收入（亏损）	(35,094)	2,242
折旧及摊销	225,755	220,242
购入无形资产摊销	11,041	11,041
现金变动净额	(29,318)	99,523

资本开支概要

- 二零零六年第三季资本开支为 157,400,000 元。
- 计划下的二零零六年资本开支总额将约为 1,000,000,000 元。

二零零六年第四季指引

以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性，部分已于之前的安全港声明中阐明。

- 销售额预期比二零零六年第三季度微增 1%-2%。
- 毛利率预期介于 9%至 11%之间。
- 经营开支相对销售的百分比预期介于 12%-15%。
- 非经营利息支出预期介于 14,000,000 元至 17,000,000 元之间。
- 资本开支预期约介于 300,000,000 元至 320,000,000 元之间。
- 折旧及摊销预期约介于 255,000,000 元至 260,000,000 元之间。

近期公布

- 中芯截至二零零六年六月三十日止六个月的未经审核中期业绩公布。（二零零六年九月二十一日）
- 中芯国际宣布否认台积电的控诉并对其作出反诉。（二零零六年九月十三日）
- SMIC 和 Magma 发布基于 SMIC 90 纳米低功耗制程的集成先进参考流程（二零零六年九月十二日）
- 中芯国际 2006 年技术研讨会在上海召开。（二零零六年九月八日）
- 中芯国际参与第四届 IC CHINA 系列活动（二零零六年九月六日）
- CADENCE 与中芯国际集成电路制造有限公司为系统级芯片的节能提供 90 纳米低功耗解决方案（二零零六年九月六日）
- 芯原和中芯国际共同宣布 0.13 微米低漏电半导体标准设计平台正式发布（二零零六年九月六日）
- SMIC 和 SYNOPSYS 推出 90 纳米设计的参考设计流程 3.0 版（二零零六年九月五日）

- 有关与台积电达成和解协议之事宜。（二零零六年八月二十八日）
- 更改香港主要营业地点。（二零零六年八月二十八日）
- 中芯二零零六年第二季经营业绩公布。（二零零六年七月二十八日）

上述公布详情请参阅中芯网站。

http://www.smics.com/website/enVersion/Press_Center/pressRelease.jsp

合并资产负债表 (美元)

	截至以下日期止	
	二零零六年九月三十日 (未经审核)	二零零六年六月三十日 (未经审核)
资产		
流动资产:		
现金及现金等价物	555,325,635	584,643,407
短期投资	52,441,975	3,486,997
应收账款, 已扣除拨备 (二零零六年九月三十日为 4,068,373 元, 二零零六年六月三十日为 4,360,447 元)	265,522,541	257,248,338
存货	243,956,844	217,592,385
预付款项及其它流动资产	25,624,762	20,171,994
待售资产	14,875,528	5,782,422
流动资产合计	1,157,747,285	1,088,925,543
土地使用权, 净额	38,180,494	39,975,613
厂房及设备, 净额	3,295,734,677	3,378,265,128
购入无形资产, 净额	172,279,451	183,230,540
股权投资	14,663,371	15,760,166
其他长期预付款	4,568,174	4,957,320
递延税资产	22,014,394	18,892,396
资产合计	4,705,187,846	4,730,006,706
负债及股东权益		
流动负债:		
应付帐款	353,325,028	429,813,127
预提费用及其它流动负债	107,858,006	85,373,210
短期借款	45,000,000	118,283,829
长期票据的即期部份	29,492,873	29,242,001
长期借款的即期部份	47,160,000	47,160,000
应付所得税	39,875	20,548
流动负债合计	582,875,782	709,892,715
长期负债:		
长期票据	91,314,355	90,537,615
长期借款	963,138,943	830,742,999
与特许权协议相关的长期应付款	21,597,408	23,507,429
其它长期应付款	6,666,667	10,000,000
长期负债合计	1,082,717,373	954,788,043
负债合计	1,665,593,155	1,664,680,758
少数股权	39,741,186	37,066,848

股东权益：

普通股，面值 0.0004 元，法定股份为 50,000,000,000 股，截止二零零六年九月三十日已发行股份为 18,402,634,216 股，未发行的股份为 18,342,734,332 股。

	7,361,054	7,337,094
认股权证	32,387	32,387
额外缴入股本	3,281,801,407	3,275,146,135
累计其它综合盈余（亏损）	173,321	163,674
累计亏绌	(289,514,664)	(254,420,190)
所有股东权益合计	2,999,853,505	3,028,259,100
总负债及股东权益合计	4,705,187,846	4,730,006,706

合并营运报表
(美元)

	截至以下日期止三个月	
	二零零六年九月三十日 (未经审核)	二零零六年六月三十日 (未经审核)
销售额	368,926,309	361,445,898
销售成本	336,160,028	312,229,121
毛利	32,766,281	49,216,777
经营费用:		
研究和开发	27,319,652	24,344,979
一般及行政	4,215,807	16,837,020
销售和市场推广	3,613,868	3,918,343
购入无形资产摊销	11,041,090	11,041,090
经营费用总额	46,190,417	56,141,432
经营亏损	(13,424,136)	(6,924,655)
其它收入(支出):		
利息收入	2,970,318	4,039,328
利息支出	(12,247,344)	(12,214,076)
其它, 净额	(11,669,620)	(1,316,005)
其它收入(支出), 净额	(20,946,646)	(9,490,753)
税前净亏损	(34,370,782)	(16,415,408)
所得税利益(费用)	3,047,443	18,891,787
少数股权	(2,674,339)	767,652
股权投资亏损	(1,096,796)	(1,002,169)
普通股持有人应占收入(亏损)净额	(35,094,474)	2,241,862
每股股份净收入(亏损), 基本	(0.0019)	0.0001
每股美国预托股份净收入(亏损), 基本(1)	(0.0956)	0.0061
每股股份净收入(亏损), 摊薄	(0.0019)	0.0001
每股美国预托股份净收入(亏损), 摊薄(1)	(0.0956)	0.0060
用作计算基本每股普通股收入 (亏损)净额的股份(以百万计)	18,356	18,303
用作计算摊薄每股普通股收入 (亏损)净额的股份(以百万计)	18,356	18,729

* 递延股票报酬摊销乃关于:

销售成本	2,840,286	3,014,596
研究和开发	1,179,175	1,254,569
销售和市场推广	1,190,467	1,227,469
一般管理	493,529	509,831

(1) 每股美国预托股份等于 50 股普通股。

合并现金流量表 (美元)

	截至以下日期止三个月	
	二零零六年九月三十日 (未经审核)	二零零六年六月三十日 (未经审核)
经营活动:		
净收入 (亏损)	(35,094,474)	2,241,862
净收入 (亏损) 至经营活动所得 (所耗) 现金净额对账的调整:		
少数股权	2,674,339	(767,652)
处置厂房及设备亏损	(872,422)	(516,812)
折旧及摊销	225,754,616	220,242,447
购入无形资产摊销	11,041,090	11,041,089
递延股票报酬摊销	5,703,457	6,006,465
贷款前端费用摊销	179,846	59,949
非现金长期票据利息费用	1,368,710	1,503,505
长期投资亏损	1,096,795	1,002,169
营运资产及负债的变动:		
应收账款	(8,274,203)	(16,227,946)
存货	(26,364,459)	(21,007,826)
预付款及其它流动资产	(5,243,468)	(316,206)
应付账款	7,039,215	(13,274,229)
预提费用及其它流动负债	24,167,325	(11,319,565)
其它长期负债	(3,333,333)	10,000,000
应付所得税	19,327	(73,086)
递延税款资产	(3,121,998)	(18,892,396)
经营活动所得现金净额	196,740,363	169,701,768
投资活动:		
购入厂房及设备	(241,450,500)	(164,934,281)
购买所获无形资产	(3,553,501)	(253,074)
出售短期投资	25,384,332	30,704
购买短期投资	(74,329,245)	-
处置厂房及设备所得款项	2,327,095	17,479
生活园区出售所得款项	5,476,213	5,631,255
投资活动所耗现金净额	(286,145,606)	(159,507,917)
融资活动:		
短期借款所得款项	75,717,105	83,161,736
长期借款所得款项	132,395,944	592,960,001
偿还长期借款支付的款项	-	(392,642,286)
偿还长期票据支付的款项	-	(15,000,000)
偿还短期借款支付的款项	(149,000,934)	(176,485,809)
支付贷款前段费用	-	(3,596,938)
行使雇员购股权所得款项	990,365	883,777
回购限制普通股	(14,589)	-

融资活动所得现金净额	60,087,891	89,280,481
汇率变动的影响	(420)	48,510
现金及现金等价物增加(减少)净额	(29,317,772)	99,522,842
现金及现金等价物一期间开始	584,643,407	485,120,565
现金及现金等价物一期间结束	555,325,635	584,643,407

于本公布刊发日期，本公司董事分别有董事会主席兼独立非执行董事王阳元先生、本公司总裁、首席执行官兼执行董事张汝京先生、本公司非执行董事姚方先生、以及本公司独立非执行董事徐大麟先生、川西刚先生、萧崇河先生、陈立武先生、虞有澄先生及江上舟先生。

承董事会命
中芯国际集成电路制造有限公司
首席执行官
张汝京

中国上海，二零零六年十月三十一日

* 仅供识别

「请同时参阅本公布于星岛日报刊登的内容。」